

EV GROUP EXPANDS COLLABORATION WITH ITRI ON HETEROGENEOUS INTEGRATION PROCESS DEVELOPMENT – August 31, 2022

EV Group (EVG) today announced that it has expanded its collaboration with the Industrial Technology Research Institute (ITRI), one of the world's leading applied technology research institutes based in Hsinchu, Taiwan, on developing advanced heterogeneous integration processes.



The image is a screenshot of a news article on the Weikeji (微科技) website. The article is titled "EV集团拓展与工研院 (ITRI) 在异构集成工艺开发领域的合作" (EV Group expands cooperation with ITRI in the field of heterogeneous integration process development). The article is dated August 31, 2022, and is attributed to "互联网" (Internet). The main text states that on August 31, 2022, EV Group (EVG) expanded its collaboration with ITRI. ITRI is a world-leading applied technology research institute based in Hsinchu, Taiwan, dedicated to developing advanced heterogeneous integration processes. The article includes two images: one of the ITRI headquarters in Hsinchu, Taiwan, and another of an EVG LITHOSCALE maskless lithography system in a cleanroom environment. The caption for the second image reads: "EV集团LITHOSCALE无掩模曝光光刻系统, 为ITRI的异构集成芯片组件系统封装联盟 (HI-CHIP) 提供革新化的工艺解决方案" (EV Group LITHOSCALE maskless lithography system, providing innovative process solutions for ITRI's heterogeneous integration chip component system packaging alliance (HI-CHIP)).

微科技 首页 - 快讯

EV集团拓展与工研院 (ITRI) 在异构集成工艺开发领域的合作

2022年08月31日 来源: 互联网

2022年8月31日, 奥地利弗洛里安——为MEMS、纳米技术和半导体市场提供晶圆键合和光刻设备的领先供应商EV集团 (EVG) 今天宣布扩大与台湾工业技术研究院 (ITRI) 的合作范围。ITRI是世界领先的应用技术研究机构之一, 总部位于中国台湾新竹, 致力于开发先进的异构集成工艺。



工业技术研究院 (ITRI) 总部, 中国台湾新竹

在台湾地区经济事务部 (MOEA) 的工业技术部 (DoIT) 的支持下, 工研院成立了异构集成芯片组件系统封装联盟 (HI-CHIP), 旨在创建涵盖封装设计、测试验证和试生产的生态系统, 实现供应链本地化, 进一步拓展发展机遇。EV集团作为HI-CHIP联盟成员, 已提供多台最先进的晶圆键合和光刻系统, 包括LITHOSCALE无掩模曝光光刻系统、EVG850 DB自动解键合系统和 GEMINI FB混合键合系统。工研院将在世界一流的设施中安装这些大批量制造平台, 帮助EV集团和ITRI的共同客户加速新型异构集成流程的开发, 顺利完成从研发实验室到客户晶圆厂的过渡。



EV集团LITHOSCALE无掩模曝光光刻系统, 为ITRI的异构集成芯片组件系统封装联盟 (HI-CHIP) 提供革新化的工艺解决方案

在半导体制造中，3D垂直堆叠和异构集成是指通过制造、组装和封装流程，将多个不同的组件和芯片组装成单个器件或套件，对于实现超越微缩技术（transistor scaling）的更高性能具有重要意义。借助3D和异构集成技术，高级封装中的高带宽互连功能使整体系统性能得到提升，已成为人工智能（AI）、自动驾驶和其他高性能计算应用的关键动力。为促进这种技术的发展，MOEA正在开展全台湾研发项目，包括“AI芯片异构集成模块先进制造平台”和“可编程异构3D集成”，以积极跟进和协调相关资源。

工研院电子和光电系统研究实验室副主任Robert (Wei-Chung) Lo博士介绍说：“工研院致力于通过技术研发推动工业发展、创造经济价值、增进社会福利。为此，我们专注于开发新型3D和异构芯片集成工艺，跨越整个供应链开展密切合作，实现半导体行业的持续发展和增长。我们的研究实验室拥有全自动批量制造系统，与客户晶圆厂的设施相同，包括EV集团的新型晶圆键合和光刻解决方案，因此客户能够迅速将ITRI开发的工艺配方运用于晶圆厂，从而缩短从实验室到晶圆厂的过渡时间。”

EV集团执行销售和客户服务总监兼执行委员会成员Hermann Waltl表示：“我们的三理念：创造 invent – 创新 innovate – 实施 implement的关键在于我们注重与ITRI等世界领先的研究机构合作，以加快新技术的开发和商业化，从而推动半导体行业未来的创新。我们与ITRI开展长期合作，通过合作积累世界一流的研究专业知识，进一步加强我们在台湾的过程支持基础设施建设。近年来，EV集团与ITRI的合作得到了显著扩展，能够更好地满足集团本地客户和合作伙伴日益增长的需求，帮助他们克服挑战。我们还在台湾多个地区设立了卓越流程和应用工程团队，与奥地利总部的EV集团异构集成能力中心提供的服务互为补充。”

关于工业技术研究院 (ITRI)

工业技术研究院 (ITRI) 是世界领先的技术研发机构之一，致力于为人类社会创造美好未来。工研院创办于1973年，在推动台湾从劳动密集型产业转变为创新驱动型产业方面发挥了重要作用。为满足市场需求，顺应全球趋势，公司制定了2030年科技战略与路线图，重点关注智能生活、品质健康和可持续环境。工研院还着力强化智能化赋能技术，支持多元化应用。

多年来，工研院始终坚持孵化初创公司和衍生公司，促进了联华电子和台积电等知名企业的诞生。除台湾总部外，工研院还在美国、欧洲和日本等地设立分公司，以扩大研发范围，促进全球国际合作。

关于 EV 集团 (EVG)

EV集团 (EVG) 是为半导体、机电系统 (MEMS)、化合物半导体、功率器件和纳米技术器件制造提供设备与工艺解决方案的领先供应商。主要产品包括：晶圆键合、薄晶圆处理、光刻/光刻纳米压印 (NIL) 与计量设备，以及光刻胶涂布机、清洗机和检测系统。EV集团成立于1980年，可为全球各地的客户和合作伙伴网络提供服务与支持。

<http://www.ivvtech.cn/v-1-146592.html>